

第54回 グラインディング・ アカデミー 研磨加工の基礎 —基礎から最新技術まで—

【主催】(公社)砥粒加工学会企

砥粒加工学会では、加工技術の基礎から最新技術までを理解するための入門教育講座として「グラインディング・アカデミー」を定期的で開催しています。切削、研削、研磨、工作機械の分野の第一人者によるわかりやすい講義は、毎回ご好評をいただいております。今回は、研磨加工の基本原則から現場に必要な知識までを詳しくご講義いただきます。もう一度学習したい技術者や新入社員、大学院の学生の皆様方の多数の聴講をお待ちしております。また、本講義は教育に重点を置いた教材を使用いたしますので、学校教員の皆様の教育手法の向上セミナーとしても十分活用できる内容になっております。

◆日時： 令和5年10月26日(木) 10時00分～17時00分

◆開催方法： オンライン

◆内容：

10:00～10:10	開催の挨拶	(公社)砥粒加工学会 企画委員長 水谷 正義 氏
10:10～10:55	研磨加工/CMP技術の基礎と応用 「研磨の原点から先端的半導体デバイスを支える超精密研磨/CMP技術」	九州大学 土肥 俊郎 氏
11:05～11:50	研磨加工/CMP技術の基礎と応用II 「超精密研磨/CMPの加工メカニズムとポイント」	九州大学 土肥 俊郎 氏
11:50～12:45	休憩	
12:45～13:30	研磨加工/CMP技術の基礎と応用III 「超精密平坦化CMP技術の基本技術と応用」	九州大学 土肥 俊郎 氏
13:40～14:40	研磨加工/CMP技術の基礎と応用IV 「超難加工半導体基板の加工プロセス/Beyond the CMP技術」	九州大学 土肥 俊郎 氏
14:50～15:50	両面研磨の理論構築を目指して	金沢大学 橋本 洋平 氏
16:00～17:00	両面研磨加工の特徴と課題	八千代マイクロサイエンス(株) 藤森 幸広 氏

◆定員： なし

◆参加費： 正会員・賛助会員 15,000 円(税抜 13,637 円 消費税率 10% 税額 1,363 円), 学生会員 5,000 円(税抜 4,546 円, 消費税率 10% 税額 454 円), シニア会員 10,000 円(税抜 9,091 円, 消費税率 10% 税額 909 円), 非会員 30,000 円(税抜 27,273 円, 消費税率 10% 税額 2,727 円), 学生非会員 10,000 円(税抜 9,091 円, 消費税率 10% 税額 909 円)

◆申込締切： 令和5年10月16日(月)

◆申込先： 砥粒加工学会 web サイト[行事案内]>[イベント情報]にて、第54回グラインディング・アカデミー
https://www.jsat.or.jp/GrindingAcademy54_231026 の登録フォームよりお申し込みください。

◆注意事項：

- ・ 個人単位でお申込みください。
- ・ ご入金確認後、視聴の URL をお送り致します。
直前のご入金の場合、URL のご連絡が間に合わない場合がございますのでご了承ください。
- ・ 講習会の静止画 / 動画撮影、録音は禁止です。
『レコーディング』ボタンで録音することは、法律で禁止されています。
- ・ 講演の音声、スライドの著作権は、発表者に帰属します。

◆問合せ先： (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 セラミックビル 4F
TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail staff@jsat.or.jp